

证券简称：博敏电子

证券代码：603936

博敏电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活 动类别	业绩说明会
参与单位名称 及人员姓名	博敏电子 2026 年半年度业绩说明会
时间	2026 年 9 月 11 日
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长/总经理：徐缓先生 财务总监：刘远程先生 董事会秘书：刘佳杰先生 独立董事：徐驰先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	1、梅州新工厂创芯智造园的产能情况如何？ 答：尊敬的投资者您好！梅州新工厂创芯智造园（一期）于 2026 年第一季度正式投产，主要生产当前细分领域中增速最快的高多层和高可靠性 HDI 等高阶 PCB 产品，下游应用深度锚定人工智能、高速通讯、智能汽车等领域，具备 52 层、厚径比 30:1 通孔能力及 7 阶 HDI 生产能力，规划产能 36 万平方米/年，将助力公司逐步实现产品结构优化升级的同时为公

	司持续提升高阶产品结构性需求提供产能支持，进而提升高附加值产品供给能力，更好地满足下游高端市场的需求。 目前创芯智造园处于产能爬坡期，产品良率稳步提升，工艺能力持续优化，人员操作熟练度与产线运营稳定性显著增强。感谢您的关注！ 2、哪些汽车厂商现在有使用公司的产品 答：尊敬的投资者您好！长期以来，公司以客户需求为导向，凭借稳定的产品质量、高效的交付保障和一体化服务能力，积累了大量国内外知名品牌及行业标杆客户，客户结构持续优化，客户粘性不断增强。现有客户广泛分布于多个高成长性领域，并且多次收获核心客户颁发的优秀供应商荣誉，良好的客户基础为公司业务规模持续扩张提供有力支撑。 其中，汽车电子领域客户包括比亚迪、佛吉亚、森萨塔、华阳通用、广汽、现代、MOBIS 等。现阶段其他新增客户的送样验证进展，因涉及客户保密要求及认证结果存在不确定性，公司暂不逐一列示，请以公司披露的信息为准。感谢您的关注！ 3、今年公司有何技术创新的方向或目标 答：尊敬的投资者您好！公司坚持以技术创新驱动发展，围绕高频高速、高密度集成、新材料应用三大方向持续加大研发投入。公司技术创新方向与进展可从以下三个方面说明： （1）聚焦高端制程，巩固高多层与高阶 HDI 领先优势：2026 年，公司 PCB 技术创新以 AI 算力、光通信等高端应用需求为导向，重点突破高阶 HDI、UHDI 及超高层板量产工艺。报告期内，公司在 PCB 高阶 HDI、≥68 层超高层板量产、UHDI、多层 PTFE-FPC、Coreless&ETS 工艺及 mSAP 先进工艺等关键技术领域保持技术优势或取得关键突破；其中自主研发 ETS 精细线路工艺实现 15 μm/15 μm 稳定量产。
--	--

	（2）完善平台化能力，推进埋嵌技术应用方案：公司是行业内少数同时掌握 PCB 埋嵌平台工艺与陶瓷基板技术的企业，公司牵头制定并发布了国内首部《埋置或嵌入铜块印制电路板规范》团体标准，填补了国内该领域技术标准空白，具备埋嵌芯片、陶瓷、铜块等先进封装技术能力。在汽车电子领域，PCB 埋嵌功率芯片技术可显著降低信号寄生杂感、提升电流转换效率，相关产品已进入送样验证阶段；在 AI 算力领域，公司成功实现 PCB 埋嵌氮化硅陶瓷基板在矿机类加速卡客户的打样验证，该技术可有效解决高功率芯片的散热难题，未来应用前景广阔。 （3）强化陶瓷衬板工艺自主能力，拓展高端散热应用场景：公司陶瓷载板技术以 AMB 工艺为核心，持续提升全流程自主可控能力。子公司深圳博敏是少数同时具备 AMB/DPC 陶瓷衬板全工艺量产能力的本土供应商，拥有自主知识产权的钎焊料技术，全面掌握从烧结、图形蚀刻到表面处理的全工艺流程，产品具备性能优越、质量可靠、成本优胜等特点。目前已形成覆盖 AMB、DBC、DPC 等工艺的完整产品矩阵。感谢您的关注！
--	--